




RISE Corporation

Corporate Profile

CORPORATE PROFILE

-会社情報-

会社名	株式会社ライズコーポレーション	
設立	1990年9月	
資本金	10,000,000円	
役員	代表取締役会長	花塚 勇三郎
	取締役社長	柳田 進
顧問税理士	税理士法人ASUWA	高橋俊介
主要取引銀行	京都銀行 京都中央信用金庫 東京三菱UFJ銀行 ゆうちょ銀行 日本政策金融公庫	
関連企業	イーストライズ株式会社 株式会社エイチエスパートナーズ ライズエイト株式会社 株式会社塩屋 株式会社インフィニティソリューションズ	
所在地	〒604-8156 京都府京都市中京区室町通錦小路上ル 三洋室町ビル TEL 075-254-0632 FAX 075-221-8807	
ホームページ	https://www.rise-corp.jp/	
業務内容	プリント基板設計・製造、調達 シミュレーション評価・解析サービス	

～回路エンジニアの方々と共通言語で会話できるように～ これが私たちのコンセプトです。

プリント配線板の設計では、製品コンセプトや意匠からくる物理的な制限の中で回路を実現させ
インタフェースやさまざまな規格のコンプライアンスを達成しなければなりません。

私たちは、幅広い分野に対応した基板設計実績とボードテクノロジーにより、お客様のアイデアや
企画を形にするソリューションをご提供いたします。

創業以来、京都の地で培ったきたノウハウを基に皆さまのお役に立てるよう取り組んでまいります。



物理的実現性

独自の計算手法で限られたスペースで回路の収容性と実現性を検証いたします。

信号伝搬性

確実に信号を伝えるため、反射やクロストークなど伝送の原理原則から、遅延・タイミング評価をいたします。

電源供給性

電源の供給源からデバイスの内部まで、その電源供給経路における電圧変動要因のインダクタンス成分を理解することが重要です。

電磁干渉抑制

不要電磁放射の増大を招く電源-GNDプレーン間の共振を解析いたします。
プレーンの形状変更や、コンデンサ配置の最適化が有効となります。

製造可能性

基板内に回路が収まれば良しとはせず、作り易さや生産性といった点も考慮いたします。

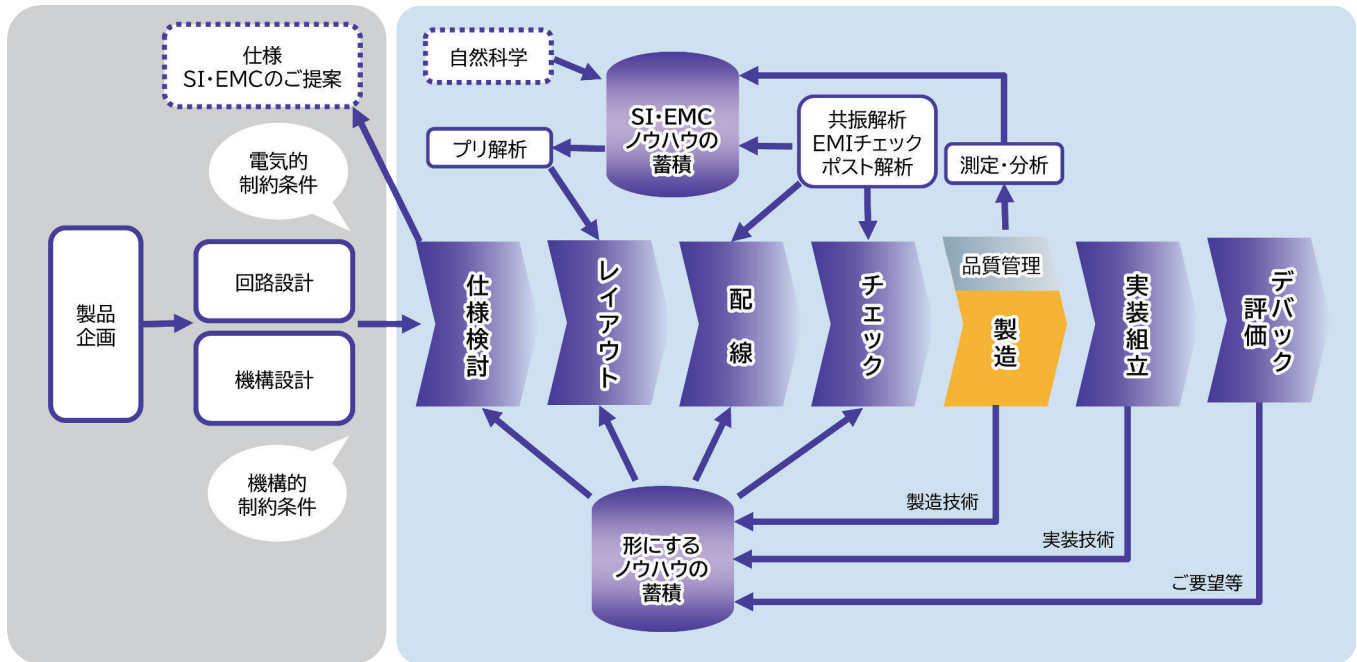
配線設計技術、シミュレーション評価

高速デジタルボード配線設計技術

高密度実装ボード配線設計技術

伝送線路解析、EMC共振解析等シミュレーション評価

スイッチング電源配線設計技術



プリント配線版製造・調達

1層～高多層基板

インピーダンス制御基板

メタル・熱対策基板（アルミ・銅）

厚銅・大電流基板

フレキシブル基板

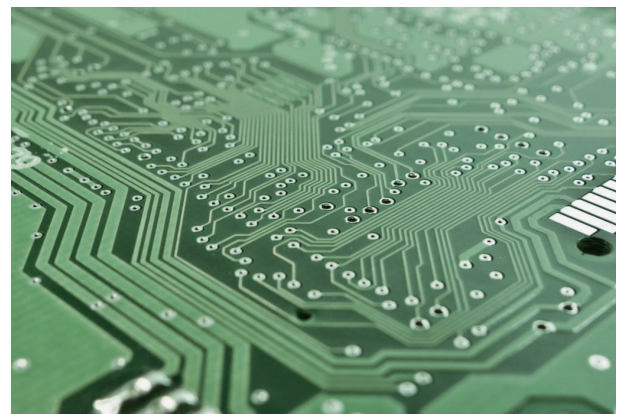
その他、多種多様に対応可能

その他多種多様な基板制作

機構系CADのDXFファイル

JPG/BMP/PDFファイル・紙の図面

生基板からのコピー など



弊社納品プリント基板(一例)